# 8인치 반도체 및 태양광 기판 핸들링용 고정밀 Esd 세이프 Peek 웨이퍼 진공 흡착 펜

품목 번호: PL-CP115

소개

정밀 반도체 및 태양광 8인치 웨이퍼 핸들링을 위해 설계된 고성능 ESD 세이프 PEEK 웨이퍼 진공 흡착 펜입니다. 이 맞춤형 솔루션은 중요한 클린룸 환경과 민감한 기판 이송 공정을 위해 우수한 화학적 저항성과 기계적 내구성을 제공합니다.

자세히 알아보기

| 응용 분야 | 설명 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 웨이퍼 검사 | 광학 또는 SEM 검사 스테이션으로부터/으로의 8인치 실리콘 웨이퍼 수동 이송. | 최소 접촉 면적이 표면 결함 발생 위험을 줄입니다. |
| 태양광 전지 분류 | 조립 및 테스트 단계 동안 고효율 태양전지의 핸들링 및 분류. | 부드러운 진공 그립을 통해 미세 균열을 방지하고 전지 효율을 유지합니다. |
| 웻 벤치 공정 | 습식 화학 환경에서 화학 배스 또는 린싱 스테이션 간 기판 이송. | 가혹한 공정 화학 물질 및 습기에 대한 탁월한 저항성. |
| 박막 증착 | PVD/CVD 진공 챔버 또는 로드 락으로부터/으로의 기판 배치 및 제거. | 고온 증착 사이클 후 핸들링을 가능하게 하는 높은 열 안정성. |
| 클린룸 연구개발 | 첨단 소재 연구개발 시설에서의 일반 기판 핸들링. | 입자 비산을 최소화하여 엄격한 ISO 청정도 표준을 유지합니다. |
| 다이 본딩 준비 | 다이싱 또는 후속 다이 본딩 작업을 위한 웨이퍼의 수동 포지셔닝. | ESD 세이프 특성이 민감한 마이크로 회로의 잠재적 결함을 방지합니다. |
| LED 기판 핸들링 | LED 칩 제조 중 사파이어 또는 SiC 기판의 정밀 조작. | 미끄러짐이나 긁힘 없이 단단하고 연마된 표면에 안전한 그립. |

| 사양 카테고리 | PL-CP115 사양 상세 |
|---|---|
| 모델 식별 | PL-CP115 시리즈 |
| 주요 소재 | 고성능 ESD 세이프 PEEK |
| 기판 호환성 | 완전 맞춤형 (8인치/200mm 웨이퍼에 최적화) |
| 표면 저항 | 지정된 ESD 세이프 범위로 맞춤 설정 가능 (예: 10^6 - 10^9 Ω) |
| 작동 온도 범위 | 공정 요구 사항에 기반한 맞춤형 |
| 화학적 호환성 | 범용 (대부분의 산, 염기 및 용제에 대해 높은 저항성) |
| 진공 연결 타입 | 시설 진공 라인 또는 휴대용 펌프에 맞는 맞춤형 사이징 |
| 팁 구성 | 요청 시 맞춤 형상 제공 가능 (평평, 곡선, 다중 포인트) |
| 클린룸 등급 | ISO Class 3 - 8 호환 (응용 분야에 따라 다름) |
| 제조 방법 | 맞춤형 사양에 따른 정밀 CNC 가공 |
| 핸들 치수 | 고객 선호도에 맞춘 인체공학적 맞춤형 |